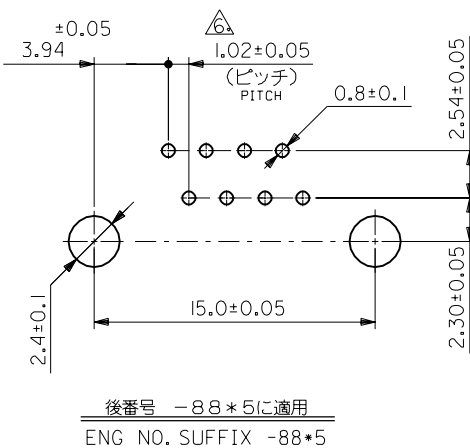
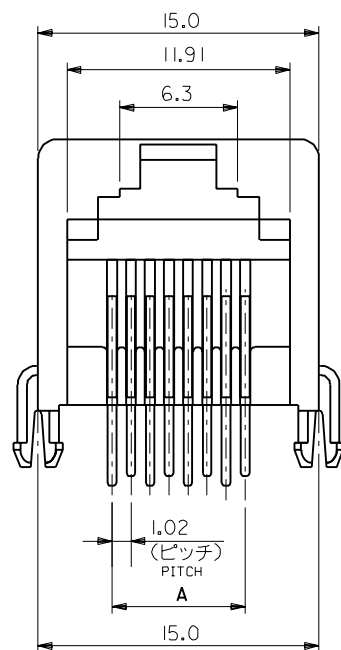
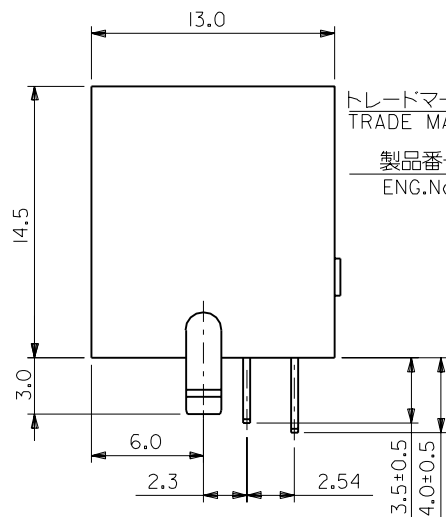
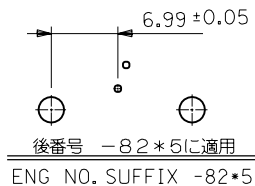
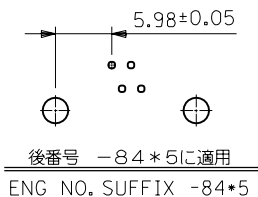
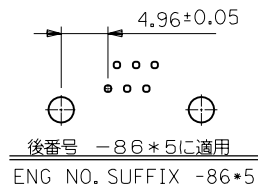




基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)



トレードマーク
TRADE MARK
製品番号
ENG.No.



角度	ANGLE
30 以上 OVER	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	
10 未満 UNDER	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

注) NOTES

1. 材質 MATERIAL

ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0

ターミナル: リン青銅

TERM.: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様 PLATING

接点部: 金メッキ、表参照

CONTACT AREA: GOLD PER TABLE

半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.

SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.

下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.

UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.

3. 推奨基板厚: t=1.6±0.05

RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05

△ 金メッキ厚標示

COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING

黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.

YELLOW: 0.1µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.

オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.

ORANGE: 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.

5. ハウジングの色は、グレイ。

HOUSING COLOR IS GRAY.

△ 公差非累積。

NON-ACCUMULATIVE

8	8	7.11	1.27	52018-8845
			0.76	-8835
			0.38	-8825
			0.1	-8815
	6	5.08	1.27	-8645
ポジション POSITION	4	3.05	1.27	-8445
	2	1.02	1.27	52018-8245
	(A)		金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (µmMIN.)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO. —	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—	ENG. NO. SD-52018-8**5	
被覆外径 INS. RANGE		—	REV B	
DRAWN BY '89/10/30 CHK'D BY '96/3/8 A. HIRAMOTO H. HIRAMOTO		DATE	TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y	
APP'D BY '96/3/8 M. FUKUSHIMA		尺度 SCALE 4 - 1		